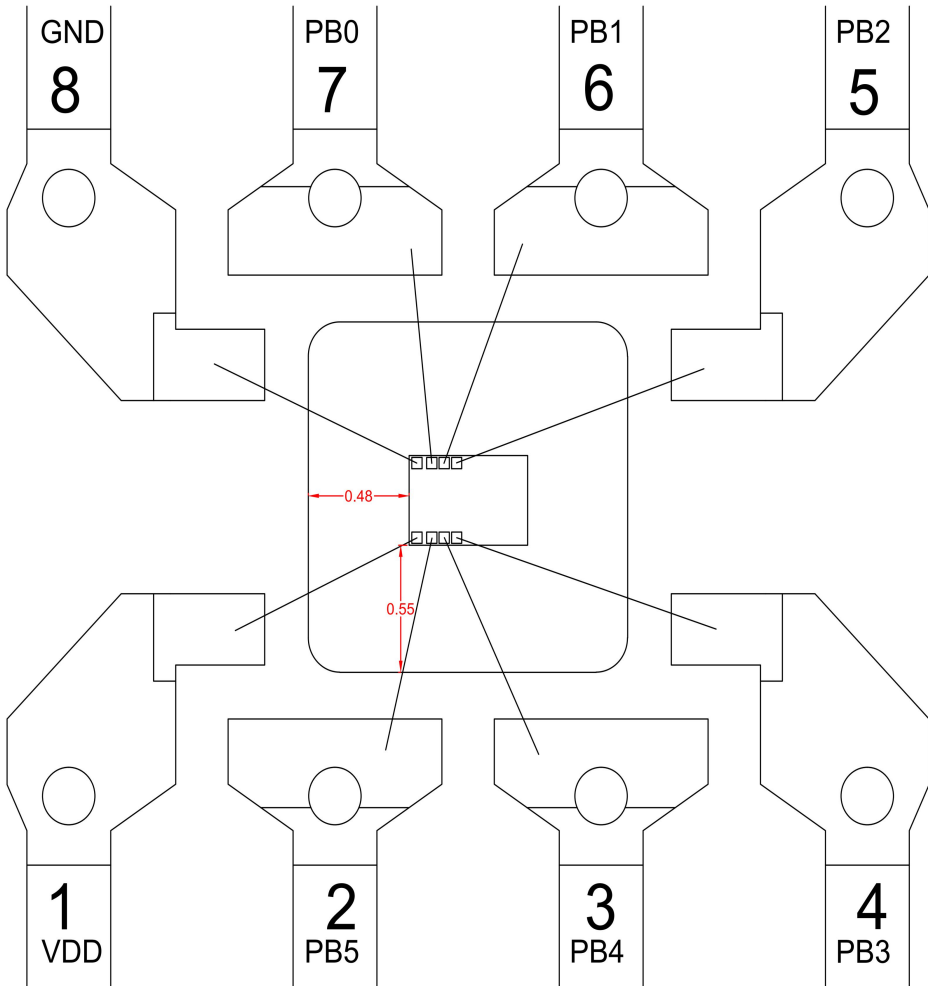




# 江苏恩微电子有限公司焊线图

焊线图编号	JSNV-0002-SZ037-SOP8L			版本信息		
				版本	修改内容	日期
芯片名称	产品名称	封装形式	客户代码	A	初版发行	2002/9/30
HS6001	HS16P1880	SOP8	SZ037			



粘片注意事项
焊线注意事项 PAD下方是否有敏感器件: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 铝层厚度: 1.2um
塑封注意事项
引线框进料方向

封装形式	SOP8	芯片尺寸	390*565um	减薄厚度	300um	晶圆尺寸	12寸	划片槽宽	60um
框架型号	SOP8-12R-60*60			焊点尺寸	49*49um			焊点间距	NA
吸嘴型号	RT-020			焊线类型	合金线			焊线条数	8
顶针型号	17-0.7-10-0.02			焊线线径	20um			起始管脚	NA
粘片胶类型	导电胶			铝层厚度	1.2um			铝层层数	3
粘片胶型号	首选: S210	劈刀型号	首选: BBN-090-2634-5P101	塑封料型号	首选: KHG 500				
	备选:		备选:		备选:				

备注:

制图	陈菲菲	审核	陈爱强	批准	唐友胜	客户确认	
日期	2024/9/30	日期	2024/9/30	日期	2024/9/30	日期	